

## Datenblatt

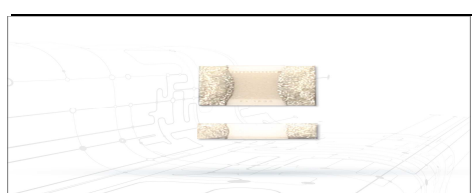
## 08x05SMDPt100B-C

## 181008

### Kurzbeschreibung

Dieser Platin-Chip-Temperatursensor zeichnet sich durch seine geringe Baugröße aus und kann deswegen eine sehr hohe Bestückungsdichte zulassen. Er wird bevorzugt für die automatisierte Bestückung eingesetzt, z.B. von elektrischen Leiterplatten in Großserienkonfektion.

### Maße in mm

	L	B	H	Lötanschluss
	2,0 ±0,2	1,3 ± 0,2	0,5 ±0,2	Ca. 0,4

### Technische Daten

Nennwiderstand R <sub>0</sub> bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
100 Ω	DIN EN 60751	F 0,3 (DIN B)	08x05SMDPt100B-C	181008

Temperaturbereich:	-50 °C bis +150 °C im Dauerbetrieb Gültigkeit der Toleranz F 0,3: -50 °C bis +150 °C		
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K		
SMD Baugröße:	entsprechen den Normen CECC 40401-004/DIN 45921		
Verarbeitung:	Reflowlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 240°C/8s) Schwall-Wellenlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 260 °C /10 s)		
Lötanschlüsse:	galvanisch verzinnete Rundumkontaktierung mit Diffusionssperre		
Einsatzbedingungen:	Der Sensor darf nicht ungeschützt in feuchter Umgebung oder aggressiver Atmosphäre eingesetzt werden.		
Langzeitstabilität:	max. R <sub>0</sub> -Drift ≤ 0,05 % /Jahr		
Isolationswiderstand:	>10 MΩ bei Raumtemperatur		
Erschütterungsfestigkeit:	DIN EN 60751, Abs. 4.4.2.		
Selbsterwärmung:	0,15 K/mW		
Ansprechzeit:	Bewegtes Wasser (v=0,4 m/s):	τ <sub>0,5</sub> =0,1 s	τ <sub>0,9</sub> =0,3 s
	Luftstrom (v=1 m/s):	τ <sub>0,5</sub> =2,6 s	τ <sub>0,9</sub> =7,9 s
Verpackung:	gegurtet		
<b>Hinweis:</b>	<b>Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.</b>		
RoHS konform			

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 vom 01/2007

